

次世代の成型システム

「E-cap™」

New mold system “E-cap™”

新一代成型系統

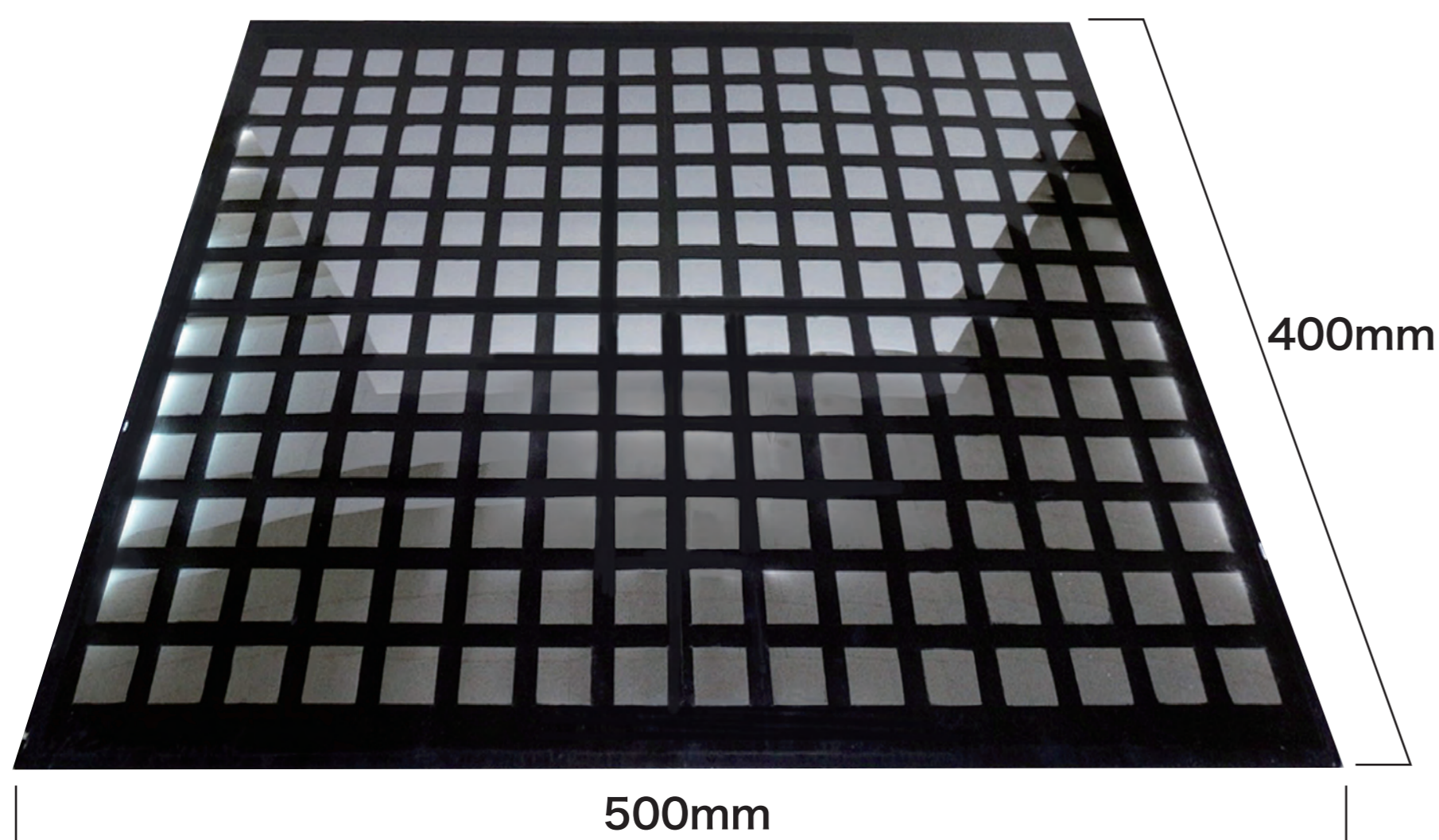
反りのない成型システム

Mold system without warpage

沒有翹曲的成型系統

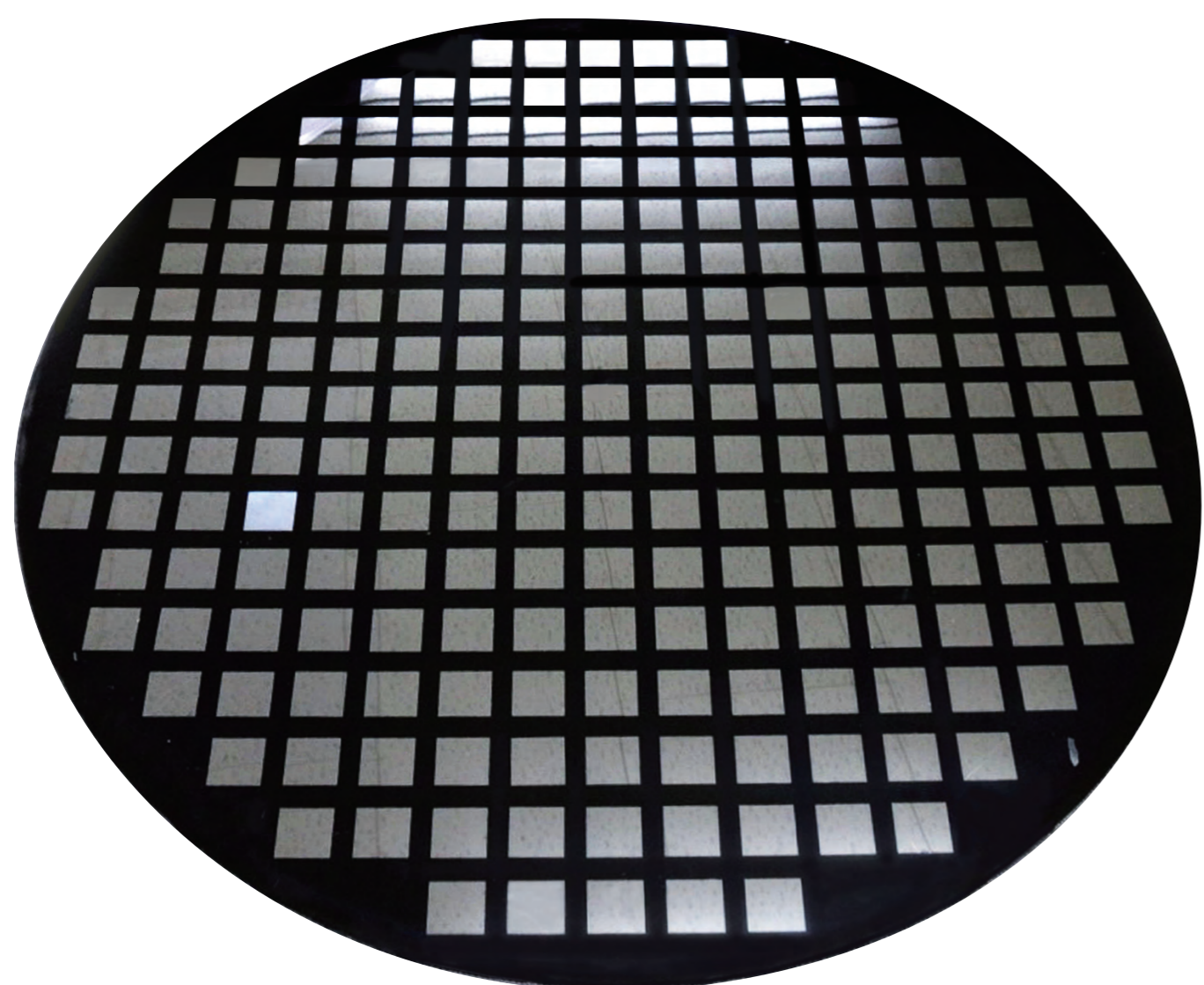
大面積Fan-out封止 Large size “Fan-out” device

反り: 3mm以下



12inchウエハレベル封止 12inch Wafer-level Si

反り: 1mm以下



パッケージ反り比較例 PKG warpage comparison

